

苏州锴威特半导体股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司高质量发展理念，维护全体股东利益，促进公司可持续发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将 2024 年上半年公司行动方案进展及成效情况报告如下：

一、聚焦夯实主业，推动高质量发展

报告期内，半导体产业整体复苏周期长于预期，回暖速度呈现明显分化。受数字经济、AI 及新质生产力发展的推动，与数字芯片相关的晶圆代工及封测已呈恢复态势，但功率及模拟类仍不达预期。当前，功率半导体行业仍处供过于求阶段，国产功率器件厂商面临市场需求萎靡、行业竞争加剧的不利局面，产品价格持续下滑，短期看价格未出现全面上涨信号，同时叠加行业竞争同步加剧，受成本增加等因素影响，公司业绩恢复不及预期。公司始终坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，坚持把夯实主业作为应对风险、高质量发展的重要保障，深度挖掘客户需求，全力以赴开拓市场，打造优质产品，深化客户精细化运营，针对客户不同需求痛点，及时根据政策和市场导向优化调整营销策略，深耕下游消费电子、工业控制及高可靠市场并持续拓宽细分应用领域，以公司高质量发展更好的回报投资者。

公司作为典型的研发与技术创新驱动企业，持续加大对产品及核心技术的研发投入，根据市场发展趋势、下游客户需求，不断拓宽产品系列，强化自主研发产品竞争力，报告期内公司稳步推进产品研发及迭代升级。PWM 控制 IC 方面：公司持续丰富产品线，完成了反激、正激、半桥、推挽、全桥、移相全桥等隔离拓扑产品系列化，推出了输入电压高达 100V 以上同步 Buck 控制器、同步 Boost

控制器等新品。为提高电源系统效率，推出了可支持反激、QR、LLC 等拓扑的同步整流驱动 IC，工作频率可高达 1MHz，工作电压可达 300V。功率驱动 IC 方面：公司推出 80V 3A 集成 MOSFET 的单芯片 H 桥驱动芯片，同时可支持 100% 占空比工作中，进一步提升系统的安全及可靠性；公司推出 180V GaN 专用半桥驱动芯片，工作频率高达 1MHz 以上。在功率 MOSFET 方面，报告期内公司开发完善了沟槽 MOSFET 及高压超结的工艺平台优化和产品布局，开发了 100V SGT 工艺平台及 12 寸 20V-40V 的沟槽工艺平台，完成了 650V 100A 大电流的超结产品开发。SiC MOSFET 方面：公司加大 SiC MOSFET 加工的产能布局及工艺平台的开发，报告期内与国内晶圆代工厂合作开发了 1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET 的生产工艺平台，其中 1200V SiC MOSFET 工艺平台已成功进入中试阶段，新推出 2600V 和 3300V SiC MOSFET 产品，目前产品正在客户验证中。

报告期内研发人员人数增至 73 人，占公司总人数的比例为 41.71%，研发团队规模持续扩大，人员素质不断提升。

公司充分重视对研发成果进行知识产权申请和保护。本期新获授权专利 21 项（其中发明专利 19 项、实用新型专利 2 项），集成电路布图设计专有权 11 项；截至 2024 年 06 月 30 日，公司已获授权专利 109 项（其中发明专利 66 项、实用新型专利 43 项），集成电路布图设计专有权 87 项。

公司将继续强化公司的经营管理，注重人才培养与优化研发环境，不断完善人才培养体系，强化芯片的前端设计技术内生增长，促进企业价值回归。

二、坚持规范运作，不断强化合规意识

公司持续关注证券市场法治化的发展动态，结合公司实际情况，对管理制度进行了全面审查和梳理，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等 20 余项治理制度。公司立足企业发展需求，不断完善公司治理结构，提升履职效能，形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营体系，打造了权责分明的治理体系，公司规范运作水平和风险防范意识不断提升。后续公司将根据新《公司法》和监管规则要求，及时修订公司相关制度。

报告期内，公司与大股东、董监高等“关键少数”保持密切沟通。公司证券部向大股东、董监高传递《科创板监管直通车》《证券法》等最新的证券法律法规、规章制度、监管信息，及时传递分享政策动态。后续公司将持续加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程，加强政策宣导，提升履职技能，理解监管动态，不断强化合规知识储备，以推动董事、监事、高级管理人员形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，强化“关键少数”责任。

三、加强投资者沟通，注重信息披露质量

公司恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于通过与投资者建立多元化沟通方式，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，努力提高投资者关系管理水平，积极而有效地向资本市场传递公司价值，确保广大投资者的合法权益得到切实保障。

报告期内，公司充分利用上证 e 互动、投资者热线、电子邮箱、业绩说明会等多种形式与投资者保持沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，在保证信息公平的前提下，回答投资者对公司关注的问题，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

报告期内，公司常态化召开业绩说明会，在完成 2023 年度报告和 2024 年度第一季度报告披露完成后，及时召开业绩说明会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等方面进行了充分沟通，为股东提供准确的投资决策依据。

报告期内，公司持续优化传播渠道，通过官网、微信公众号等媒体平台，采用图文形式，发布公司近况、产品动态等信息，进一步提高公司资讯的传播效率和质量，使投资者能够及时、全面地了解公司的经营情况、研发情况、产品情况等。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息。后续公司将继续根据最新的监管指引，不断优化信息披露流程，努力提高信息披露质量，增进投资者了解和认同，

切实履行上市公司信息披露义务，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

四、以投资者为本，提高投资者回报

公司高度重视与股东共享企业发展成果，积极落实“以投资者为本”的上市公司高质量发展理念，实现公司与股东双赢，努力在保证主营业务发展合理需求的前提下，满足广大投资者特别是中小投资者的合理投资回报。

报告期内，公司已于 2024 年 6 月 24 日顺利实施完成 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.17 元人民币（含税），合计派发现金红利 12,526,315.87 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约 70.39%。

为回报广大投资者对公司的信任，稳定投资者信心，提振市场情绪，切实保护投资者利益，公司拟实施 2024 年度中期分红，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至目前，公司总股本 73,684,211 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,368,421.10 元（含税）。公司 2024 年半年度利润分配预案将在公司股东大会审议通过后执行。

后续公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合实际经营业绩、盈利水平，并在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，并积极探索制定股份回购方案，为稳市场、强信心积极贡献力量。

五、其他相关说明

公司将继续以“提质增效重回报”为核心，在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，在公司治理实践中，进一步突出“以投资者为本”的价值导向，努力通过改善经营业绩，规范公司运作，切实履行上市公司的责任和义务，努力回馈广大投资者的信任，维护公司市场形象，促进公司稳健、高质量发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2024年8月31日